

I N V E S T O R  
R E L A T I O N S

DUKSAN

*Hi-Metal*

2026년 1분기 IR Book

*Company Overview · Technology · 1Q Earnings*

K O S D A Q 0 6 9 3 3 0

*Strictly Confidential*

C O N T E N T S

P A R T I

회사 및 사업 소개

*Company · Business · Technology*

P A R T I I

2026년 1분기 실적

*Highlights · Earnings*

# 01

P A R T I

## 회사 및 사업 소개

---

*Company · Business · Technology*

*Profile · Products · Process · M/S Position · Customers*

# 덕산하이메탈 회사 개요

반도체 패키징 솔더볼 글로벌 리더 · Korea No.1 · Global No.1 in MSB

## DS Hi-Metal

반도체 패키징 소재 일괄 생산 체계

### Micro Solder Ball

글로벌 탑 티어 수준

### Solder Ball

국내 M/S 70%

### 30 $\mu$ m 기술

초미세 대응 가능

일괄 생산 체계 · 합성 → 정제 → 분급 → 도금 → 출하

**305** 명

임직원 (26.1Q)

**426** 억

1Q 매출액

**23** 억

1Q 영업이익

## Corporate Profile

설립일	1999년 5월
상장	KOSDAQ (2005)
대표이사	이수훈 · 김태수
본사	울산광역시 북구
자본금	9,087 백만원
주요 제품	SB · MSB · CSB · P&F
고객사	삼성전자, SK하이닉스, Amkor 등

\* 기준일: 2026년 3월말

**Why DSHM?** MSB 글로벌 경쟁 우위 · SB P-Q 상승 사이클 진입 · P&F 수익 구조 개선 · SB/CSB Capa 증설

# 제품 포트폴리오 & 시장 지위

4대 핵심 제품군 · 반도체 패키징 소 공정 소재 라인업

## SB

### Solder Ball

메모리/비메모리 반도체 패키징용  
구형 솔더 소재(≤760μm)

1Q 매출

**254**억  
+82% YoY

Market Position

**국내 70%**

P,Q 상승 사이클

## MSB

### Micro Solder Ball

FC-BGA · AI칩 · HDD용  
초정밀 미세 볼 (≤150μm))

1Q 매출

**104**억  
+63% YoY

Market Position

**글로벌 Top-tier**

핵심 성장 엔진

## CSB

### Cored Solder Ball

AP 패키징용  
고성능 Cu Core 솔더

Market Position

**글로벌 A社, S社 등**

라인 증설

## P & F 등

### Paste & Flux

SMT · Wafer Bumping용  
페이스트 & 플럭스

1Q 매출

**68**억  
+17% YoY

Market Position

**국내 S社 등**

✓ 수익 구조 개선

1Q 26 별도 매출 426억 (+63% YoY) · MSB 성장세 유지 · P&F 구조적 수익 개선 진행 중

# 핵심 솔더볼 제품군 · SB / MSB / CSB

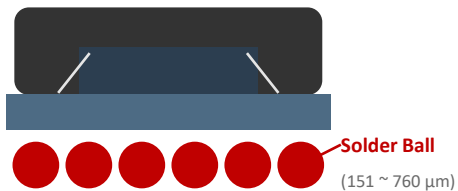
반도체 패키징 핵심 소재 · 글로벌 최고 수준의 고순도 정제기술력 — 30 $\mu$ m 초미세 대응 가능

## SB Solder Ball

151 ~ 760  $\mu$ m

BGA, BOC(FBGA), FCBGA, CSP, SiP, 2.5/3D Package 등

BGA Package



국내 M/S 70%

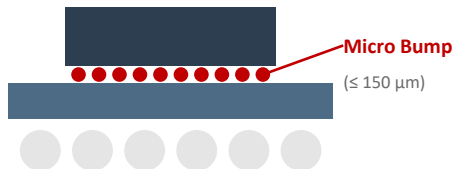
End-Use: 메모리 (DRAM · NAND) · CPU · GPU · ASIC 등

## MSB Micro Solder Ball

$\leq 150 \mu$ m (30 $\mu$ m 대응)

FC-BGA · HDD · FCCSP 등

Flip-Chip BGA



글로벌 M/S 선도

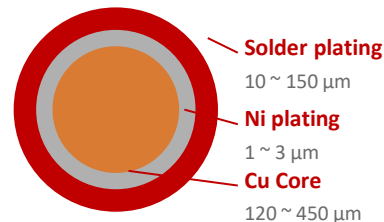
End-Use: AI 가속기 · CPU · HDD 등

## CSB Cored Solder Ball

Cu Core 120 ~ 450  $\mu$ m

AP 패키징(PoP · FOWLP/PLP) · 2.5D Package

Cored Solder Ball · Cross-section



글로벌 A社

End-Use: Mobile AP 등

1Q26 별도 매출 426억 — SB 254억 (59%) · MSB/CSB 104억 (25%) · P&F-기타 68억 (16%)

MSB 글로벌 차별화 기술 기반 글로벌 경쟁 우위 확보 · SB/CSB Capa 증설 · 수익 구조 개선

# Solder Paste & Powder · 접합용 소재

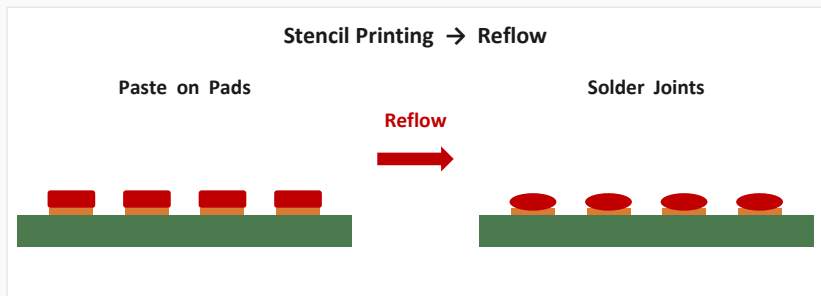
Flux + Powder 합금을 혼합한 크림형태 접합 소재 · 수익 구조 개선

## PASTE Solder Paste · 접합용 소재

Flux + Powder 합금 분말을 혼합한 크림형태 접합 소재

Wafer Bumping용 · Solder Ball 대체 (Bump 형성 / Pre-solder)

SMT용 · 기판 ↔ 디바이스 접합 / 산화 방지

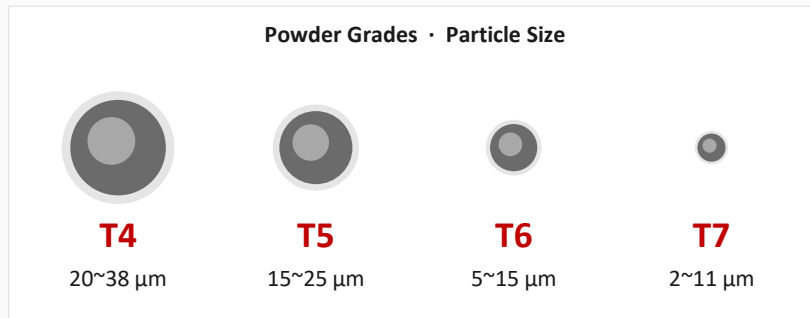


국내 s社 등 주요 SMT 고객 · 평가 인상으로 수익구조 개선

## POWDER Solder Powder · T4 / T5 / T6 / T7

용도별 입자 사이즈로 분급된 초미세 솔더 분말

T4 (㎝) → T7 (가장 미세) · 자체 합금분 활용

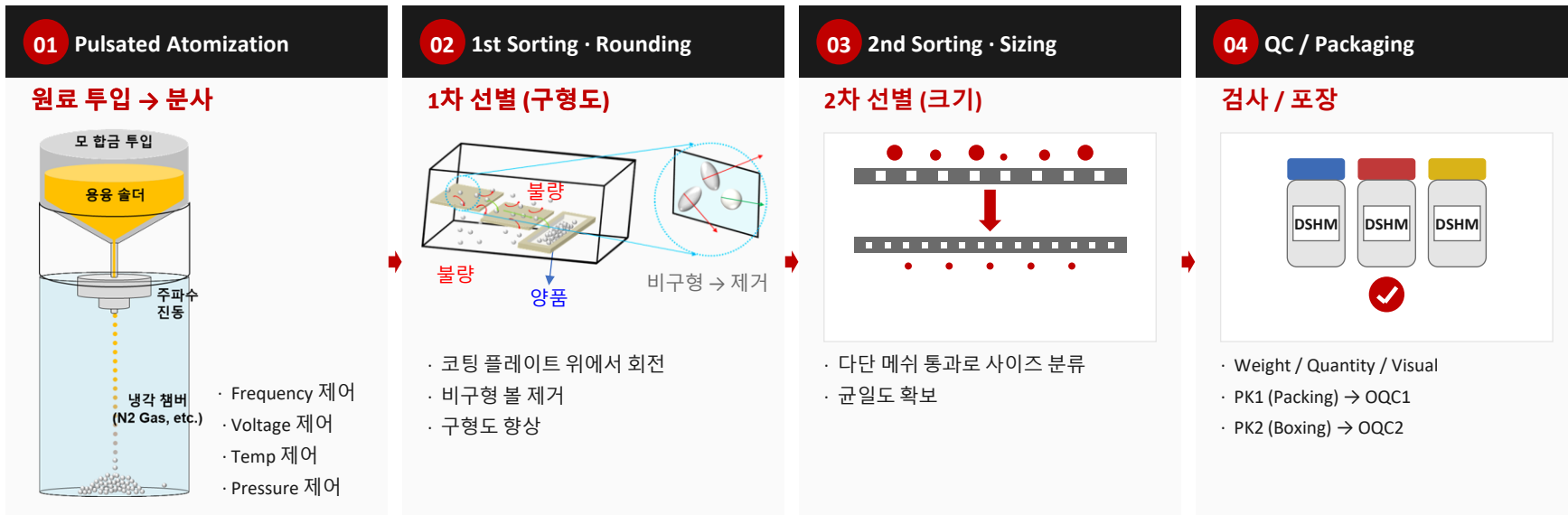


T4~T7 분급된 초미세 분말 · Solder Paste 원재료 → 글로벌 SMT 고객사

현재 P&F는 Type 4/5 (IT 제품向) 위주 저수익 라인업  
고객사 국산화 수요에 대응해 Type 6/7과 같은 고부가가치 다품종 라인업 개발 추진

# 공정 과정 · 자체 개발 PAP 공법 + 자동화 시스템

Pulsated Atomization Process (PAP) · 4단계 자동화 공정으로 30μm 초미세 슬더볼 양산



**Capacity · SB (SB + MSB + CSB) 약 20억 K / 月 · SB/CSB 라인 증설**

자체 PAP 공법 + 자동화 라인 · 글로벌 최고 수준 고순도 정제기술력으로 30μm 초미세까지 양산

# MSB 글로벌 시장 지위

Micro Solder Ball Global Top-tier · 30μm 초미세 기술 압도적 우위

## Global MSB Market Share · 2025



■ 덕산하이메탈 ■ S社 (일본)

## Competitive Edge

### 01 초미세 기술력

≤ 30μm

초정밀 대응

FC-BGA용 초미세 솔더 대응 → 글로벌 경쟁사 대비 입자 기술력 우위

### 02 전방시장 동시 수혜

AI + HDD

Dual Demand

FC-BGA(AI 가속기·ASIC) + HDD 레코딩 헤드용 수요 동시 견인  
→ 국내외 글로벌 고객사 양산 확대 사이클

### 03 Lock-in 고객 구조

국내 기판 관련 기업 +

글로벌 OSAT

핵심고객사인 국내 S社의 Full Capa 수혜 / 글로벌 고객사 M/S 확대  
→ 일본, 중국 등 신규 고객사 확대 추진

AI 인프라 투자 가속 + HDD 쇼티지 + 메모리 패키징 수요 확대 → 3대 동시 수혜 구간 진입

# 최종 적용처 분석 · 제품 → End Product

AI · Memory · Mobile AP · HDD · SMT

SB	MSB	CSB	P&F
<p>A P P L I E D T O</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 메모리 패키징 (DRAM · NAND)</li> <li>■ CPU · 일반 SoC</li> <li>■ Network ASIC</li> <li>■ Power IC · MCU</li> </ul>	<p>A P P L I E D T O</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ FC-BGA (서버 · 데이터센터)</li> <li>■ HDD</li> </ul>	<p>A P P L I E D T O</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mobile AP (FC-PoP)</li> <li>■ 2.5D Package (Warpage 개선)</li> <li>■ 고밀도 BGA</li> <li>■ 특수용도 패키지</li> </ul>	<p>A P P L I E D T O</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ MLCC · 일반 SMT</li> <li>■ Bumping用 Paste</li> </ul>
<p>메모리 수요 + DDR5 전환 + AI 서버향 수요 증가</p>	<p>AI 서버향 수요 증가 수혜</p>	<p>글로벌 A社 양산 · 글로벌 AP 제조사</p>	<p>Type 6/7 신제품 개발 추진</p>

**Growth Theme · AI 인프라 확산 → 향후 MSB(FC-BGA-GPU) + CSB(2.5D 패키지) 동반 성장 기대**  
 향후 자동차 / 데이터센터 / 모바일 등 응용처별 제품 다각화로 안정 성장 기반 구축 추진

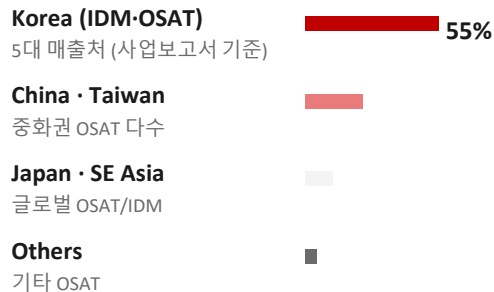
# 주요 고객사 매트릭스 · 제품·지역별 분포

제품군별 핵심 고객 5~10社 · Top 5 고객사 1Q26 매출 비중 55% 수준 · 국내 IDM·OSAT 중심 + 글로벌 분산

## PRODUCT × KEY CUSTOMERS

<b>SB</b>	<p>삼성전자 · SK하이닉스 · Amkor 등</p> <p>Korea IDM/OSAT + 글로벌 OSAT</p>
<b>MSB</b>	<p>글로벌 OSAT</p> <p>글로벌 M/S 선도 · HDD + FC-BGA 패키징 중심</p>
<b>CSB</b>	<p>글로벌 OSAT</p> <p>모바일 AP</p>
<b>P&amp;F</b>	<p>국내 S社 · 기타 SMT 고객</p> <p>수익구조 개선</p>

## GEOGRAPHIC DISTRIBUTION



### Top 5 고객 매출 집중도

5대 매출처 합산 약 54.9% (사업보고서 기준)

고객 다각화 진행 중 · CSB 단일 고객 의존 → 신규 고객 확보 추진  
 신규 샘플 진행 · 주요 신규 거래처 샘플 진행 중 (SB·MSB·CSB)

# 자회사 소개

방산·우주항공 (덕산넵코어스) + 가스용기 (덕산에테르씨티)

방 산 · 우 주 항 공

## 덕산넵코어스

DS Nepcore · 지분 63.2%

2025 연간 매출

**485억**

1Q26 매출

**120억**

사 업 영 역

### 항법 / 항재밍 솔루션

- 육·해·공 무기체계 항법정보 (8대 무기체계 적용)
  - 항법/항재밍 기술 기반 제품
  - 글로벌 Top-tier 수준 항재밍 기술력
- 주요 고객 · 국내 방산·우주 항공 관련 기업(국내 H사, L사 등)

가 스 용 기

## 덕산에테르씨티

Aether CT · 지분 91.9%

2025 연간 매출

**617억**

1Q26 매출

**141억**

사 업 영 역

### 특수가스용기 / 산업가스용기 / 수소용기

- 수소·반도체·우주항공용 특수가스 용기 제조
  - Type 1 ~ Type 4 수소용기 쉘 라인업
  - 수소 Value-Chain 전 영역 Coverage
- 주요 고객 · SK스페셜티 · 원익머트리얼즈 · 린데코리아 · 北京 Peric 등

연결 포트폴리오 · 하이메탈 (반도체 소재) + 덕산넵코어스 + 덕산에테르씨티 — 3대 사업부

1Q26 단순합산 매출 · 하이메탈 426억 + 넵코어스 120억 + 에테르씨티 141억 = 687억

# 02

P A R T   I I

## 2026년 1분기 실적

---

*Earnings*

Highlights · Earnings

# 1Q 2026 핵심 지표

별도 매출 426억 · 영업이익 23억

## 426

1Q 매출액  
yoy +63%

## 23

1Q 영업이익  
yoy -26%

## 28

당기순이익  
yoy +23%

## 5.4

% · OPM  
yoy -6.4%p

### ✓ H I G H - L I G H T

#### SB 평가 인상

원자재 변동성 확대에 따라 평가 연동 비중 확대

#### P&F 사업 수익 구조 개선

평가 인상에 따른 흑자 전환 기조 마련

#### MSB·HDD 구조적 수요 증가

글로벌 HDD 고객 향 26년 평가 협의 진행

### ⚠ W A T C H - L I S T

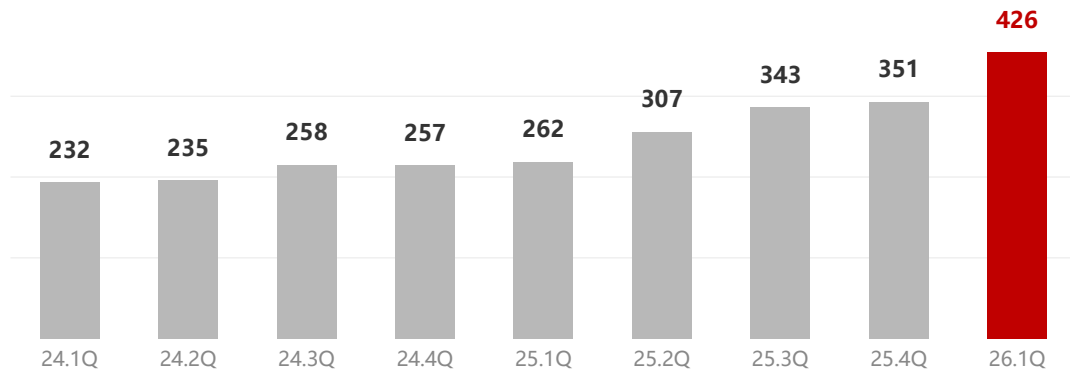
#### 1Q OP 23억

1월 원자재 가격 상승에 따른 이익률 감소

# 분기별 실적 추이 • 별도 기준

9개 분기 매출 +83% 성장 (232 → 426억)

QUARTERLY REVENUE • 별도 매출 (억원)



MIX • 1Q25 vs 1Q26 (억원)

	1Q25	1Q26	YoY
SB	140	254	+82%
MSB + CSB	64	104	+63%
P&F·기타	58	68	+17%
<b>합 계</b>	<b>262</b>	<b>426</b>	<b>+63%</b>

O P M ( % )

14.7%   13.3%   6.5%   44.1%\*   11.8%   15.2%   13.0%   9.6%   5.4%

\* 24.4Q 일회성 항목 포함

9개 분기 추세 • 매출 +83% 성장 + 분기 최대 매출 갱신 (4분기 연속)

MSB • CSB 동반 성장 • SB/CSB Capa 증설 효과 본격화 전망

# 연결 실적 · 자회사 포함

1Q26 단순합산 매출 687억 (+56% YoY) · 연결 영업이익 -7억 (YoY 적자축소)

C O N S O L I D A T E D · 1 Q 2 5 / 4 Q 2 5 / 1 Q 2 6 ( 억 원 )

구분	1Q25	4Q25	1Q26	YoY	QoQ
<b>매출 합산</b>	442	734	<b>687</b>	<b>+56%</b>	<b>-6%</b>
하이메탈	262	351	426	+63%	+21%
넵코어스	77	174	120	+56%	-31%
에테르씨티	103	209	141	+36%	-33%
<b>영업이익 합산</b>	-1	21	<b>6</b>	<b>흑전</b>	<b>-71%</b>
하이메탈	31	34	23	-26%	-32%
넵코어스	-3	20	2	흑전	-90%
에테르씨티	-29	-33	-19	축소	축소
기타/연결조정	-12	-20	-13	-	-
<b>연결 영업이익</b>	<b>-14</b>	<b>1</b>	<b>-7</b>	<b>축소</b>	<b>적전</b>

S U B S I D I A R I E S · 1 Q 2 6 I S S U E S

**덕산넵코어스** 매출 120억 · 이익 2억 (흑전)

- + 방산 양산 매출 본격화
- + 제품 믹스 개선으로 영업이익 흑자전환
- 일부 양산사업 납기 변경 영향 (신규 수주로 보완 추진)

**덕산에테르씨티** 매출 141억 · 이익 -19억

- 해외법인 재고자산평가충당금 발생 (일회성 비용)
- 일부 특수가스 제품 판매 위축 영향
- + 재고 운영 효율화 및 부진 자산 정리 추진 중
- + 수소·산업가스 등 신규 수주 활동 강화

**Key Takeaway** · 연결 영업적자는 자회사 일회성 비용 영향 — 본업 하이메탈은 건조한 실적 시현 · 자회사는 사업 정상화 및 수익성 개선 활동 추진 중

## 투자 유의사항

# DUKSAN

## Hi-Metal

### 2026 1Q IR Report

#### CONTACT

Head of IR/PR Group

Dong Jun Shin

peter1110@oneduksan.com

Seon Jong Park

sunny.park@oneduksan.com

T. 070-5066-2770

[www.dshmetal.com](http://www.dshmetal.com)

### 투자 유의사항

본 자료에 기술되어 있는 2026년 실적은 K-IFRS 기준의 내용입니다. 본 자료는 투자자들에게 정보 제공을 목적으로 덕산홀딩스(이하 회사)에서 작성되었습니다. 해당 자료의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지 됨을 알려드립니다.

또한 본 자료는 미래의 불확실성 및 위험 요인에 따라 변경될 수 있는 가정에 근거한 특정 정보를 포함하고 있습니다. 이는 세계 경제와 그에 따른 트렌드, 시장 전략 및 사업 계획 등의 미래 투자 계획을 포함합니다. 이러한 가정과 환경의 변화로 인한 변동 사항에 대하여는 당사의 책임이 없음을 양지하시길 바랍니다.

회사의 실제 실적은 당사가 예측하지 못할 수 있는 요소들로 인해 변경될 수 있습니다. 이러한 요소는 경제 침체의 심화, 고객 수요의 감소, 주요 고객의 이탈, 가격 하락 압박, 특정 프로젝트 및 설비투자에 대한 자금 조달 상의 문제 등을 포함합니다.

본 자료에 포함된 재무 정보는 외부감사인의 회계 감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료이므로, 감사 후 실제 실적에는 변동이 생길 수 있음을 양지하시길 바랍니다.